

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2026-017

## 深圳精智达技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350.2939万股，每股发行价格为人民币46.77元，募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,266.79万元后，募集资金净额为人民币98,656.46万元。

上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2026年2月28日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司深圳福城支行	771877237293	198,000,000.00	44,420,951.41	活期
兴业银行股份有限公司深圳天安云谷支行	337110100100720095	100,000,000.00	11,656,130.85	活期
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	188774084556	62,000,000.00	-	活期
中国工商银行股份有限公司深圳生态园支行	4000134919100304096	-	779.60	活期
招商银行股份有限公司深圳龙华支行	755939970510636	270,064,632.90	-	注销

行				
杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000423059	200,000,000.00	-	注销
广东发展银行股份有限公司深圳华强北支行	9550880240694300133	186,564,578.43	-	注销
中国工商银行股份有限公司深圳生态园支行	4000134919100276705	-	153,606,940.00	活期
中国银行股份有限公司南京文德路支行	554748888476	-	3,958,725.02	活期
中国银行股份有限公司苏州园区行政中心支行	526182827592	-	3,029,160.89	活期
合计	—	1,016,629,211.33	216,672,687.77	—

上述实际收到的募集资金人民币 101,662.92 万元与前次发行募集资金净额人民币 98,656.46 万元的差异为预付的保荐及承销费用人民币 100.00 万元以及其他发行费用人民币 2,906.46 万元。

## 二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

## 三、前次募集资金变更情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目存在变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况，未涉及募集资金的用途的变更。具体情况如下：

1、公司于 2025 年 2 月 18 日，召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点的议案》，公司新增控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司（以下简称“精智达集成电路”）的全资子公司深圳精智达半导体技术有限公司（以下简称“深圳半导体”）作为募集资金投资项目“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”的实施主体，同时将“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点由“深圳市龙华区鸿源鸿创科技中心”变更为“深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东”的现有租赁厂房，并使用自有资金支付募投项目租金等费用并以募集资金等额置换。公司授权深圳半导体管理层具体办理开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及其他相关事项。精智达集成电路拟使用不超过 5,000 万元募集资金向深圳半导体以实缴注册资本或提

供借款的方式划转募投项目实施所需募集资金。

截止 2026 年 2 月 28 日，精智达集成电路使用募集资金向控股子公司深圳半导体实缴注册资本 3,000.00 万元。

2、公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》；新增控股子公司苏州精智达智能装备技术有限公司（以下简称“苏州精智达”）作为募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施主体，同时，公司新增江苏省苏州市苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园作为“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点；新增杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心为“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点。公司授权苏州精智达管理层具体办理开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及其他相关事项。本公司拟使用不超过 3,000.00 万元募集资金向苏州精智达以提供借款的方式划转募投项目实施所需募集资金。

截止 2026 年 2 月 28 日，本公司向控股子公司苏州精智达借款金额为 1,000.00 万元。

上述变更未改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况**

截至 2026 年 2 月 28 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

公司于 2023 年 7 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 578.16 万元（不含增值税）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金和银行承兑汇票支付部分募投项目所

需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

## 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

新一代显示器件检测设备研发项目、新一代半导体存储器件测试设备研发项目及先进封装设备研发项目，均为公司为持续巩固核心竞争力而开展的研发投入。因上述项目无独立销售收入，故无法单独核算其直接经济效益。

补充流动资金事项，可有效缓解公司流动资金压力，为各项经营活动的顺利推进提供坚实资金保障，对公司持续健康发展具有积极意义。由于补充流动资金不直接产生营业收入，因此无法单独核算其直接经济效益。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产情况。

## 七、闲置募集资金的使用

公司于2023年7月27日召开第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2024年7月16日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024年7月27日）起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年7月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2025年7月27日）起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

截至2026年2月28日，公司募集资金进行现金管理余额为10,860.00万元。

#### **八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截至2026年2月28日，公司未使用的募集资金余额为32,527.27万元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财投资收益扣除银行手续费等的净额）。公司实际募集资金净额98,656.46万元，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

#### **九、前次募集资金使用的其他情况**

公司于2023年9月27日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司精智达集成电路提供总额不超过人民币16,200.00万元的借款，用于实施“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”，并授权精智达集成电路开立募集资金专户以进行募集资金管理。截止2026年2月28日，本公司使用募集资金向控股子公司精智达集成电路借款金额为16,200.00万元。

公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司与南京浦口经济开发区管理委员会签署《投资协议》，拟投入建设先进封装设备研发项目；同意公司使用29,960.74万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于上述项目投资。截止2026年2月28日，本公司使用募集资金向控股子公司南京精智达技术有限公司提供借款金额为9,600.00万元，实缴注册资本金额为1,500.00万元。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第七次会议，于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》拟使用超募资金人民币 10,378.83 万元（截至 2025 年 11 月 30 日账户余额，含账户利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日计算利息收入等收益后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金。公司于 2026 年 1 月 15 日完成上述补流工作，实际补充流动资金金额为 10,639.38 万元。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日

附表 1 《前次募集资金使用情况对照表》

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳精智达技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：98,656.46						已累计使用募集资金总额：70,257.22				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0						2023 年度：24,417.34				
						2024 年度：9,187.42				
						2025 年度：19,520.13				
						2026 年 1-2 月：17,132.33				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定 可使用状态日 期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额		
1	新一代显示器件检测设备研发项目	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	19,800.00	8,647.37	19,800.00	19,800.00	8,647.37	-11,152.63	2026 年 8 月
2	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	16,200.00	16,200.00	16,266.27	16,200.00	16,200.00	16,266.27	66.27	2026 年 8 月

3	补充流动资金	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	不适用
4	超募资金	超募资金用于先进封装设备研发项目	不适用	29,960.74	10,704.20	不适用	29,960.74	10,704.20	-19,256.54	2028年5月
5	超募资金	超募资金用于补充流动资金	不适用	8,695.72	10,639.38	不适用	8,695.72	10,639.38	1,943.66	不适用
合计			60,000.00	98,656.46	70,257.22	60,000.00	98,656.46	70,257.22	—	—

注：实际投资金额为实际使用募集资金账户支付的金额，包含扣除手续费后的利息及理财收入。表格中合计数与各分项加总不一致的，系保留至万元产生的四舍五入差异所致。

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：深圳精智达技术股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-2 月		
1	新一代显示器件检测设备研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
4	超募资金用于先进封装设备研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
5	超募资金用于补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	